

A collage of industrial equipment including a large metal cabinet, a yellow conveyor system, and a black robotic arm, set against a blue background with glowing lines and squares.

先進設備科技 整合領航者

# fiti 京鼎精密科技

2020年第一季 法人說明會

2020/6/29

- 公司營運概況      呂軍甫      發言人
  - ◆ 公司簡介(影片)
  - ◆ 競爭優勢及發展策略
  - ◆ 營運實績
  
- 問與答
  - 邱耀銓      總經理
  - 陳鎮福      財務長
  - 呂軍甫      發言人

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
- 本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行邀約。

01



公司簡介

02



競爭優勢及發展策略

03



營運實績

成立時間：2001/4/26

資本額：8.27億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

營業項目：

- 半導體設備、模組及關鍵性零組件之製造及銷售
- 非半導體製程及自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案

榮耀與里程碑：

- 2001 公司設立
- 2002 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產
- 2015 成功上市
- 2016 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳服務合作獎」
- 2017 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」及「全球服務快速發展優良表現獎」
- 2018 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」
- 2019 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」(連續3年獲得)

營運總部(台灣)



竹南一廠

美國

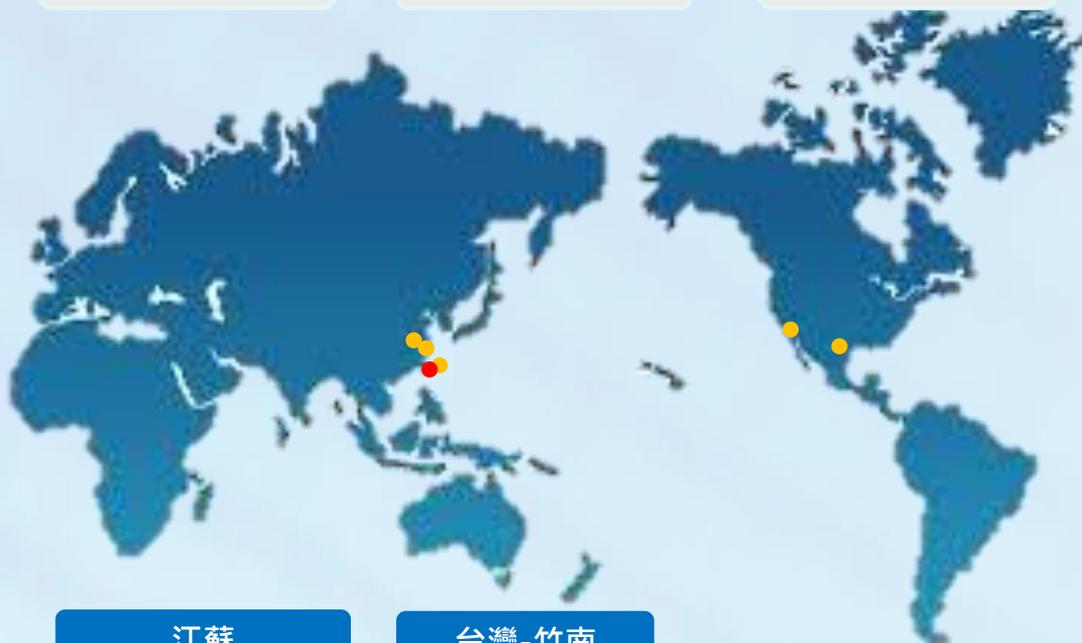


San Jose & Austin

上海



松江廠區



江蘇



昆山廠區

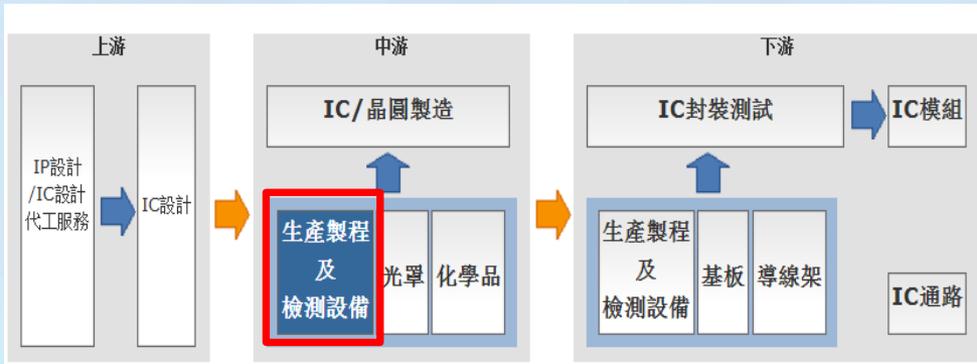
台灣-竹南



竹南二廠-2021

- ：京鼎現在據點
- ：京鼎未來擴充據點

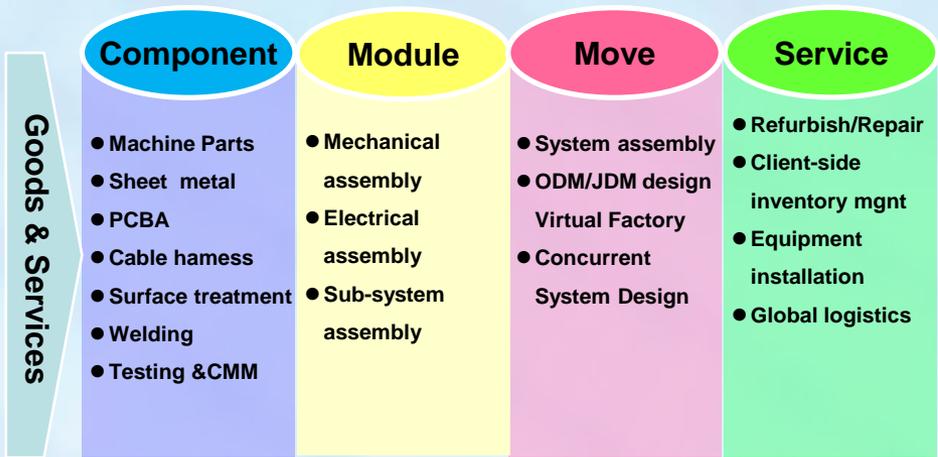
# 半導體前段製程設備



# 非半導體製程及自動化設備



## 合約製造營運模式



一次購足之整合全面解決方案



01

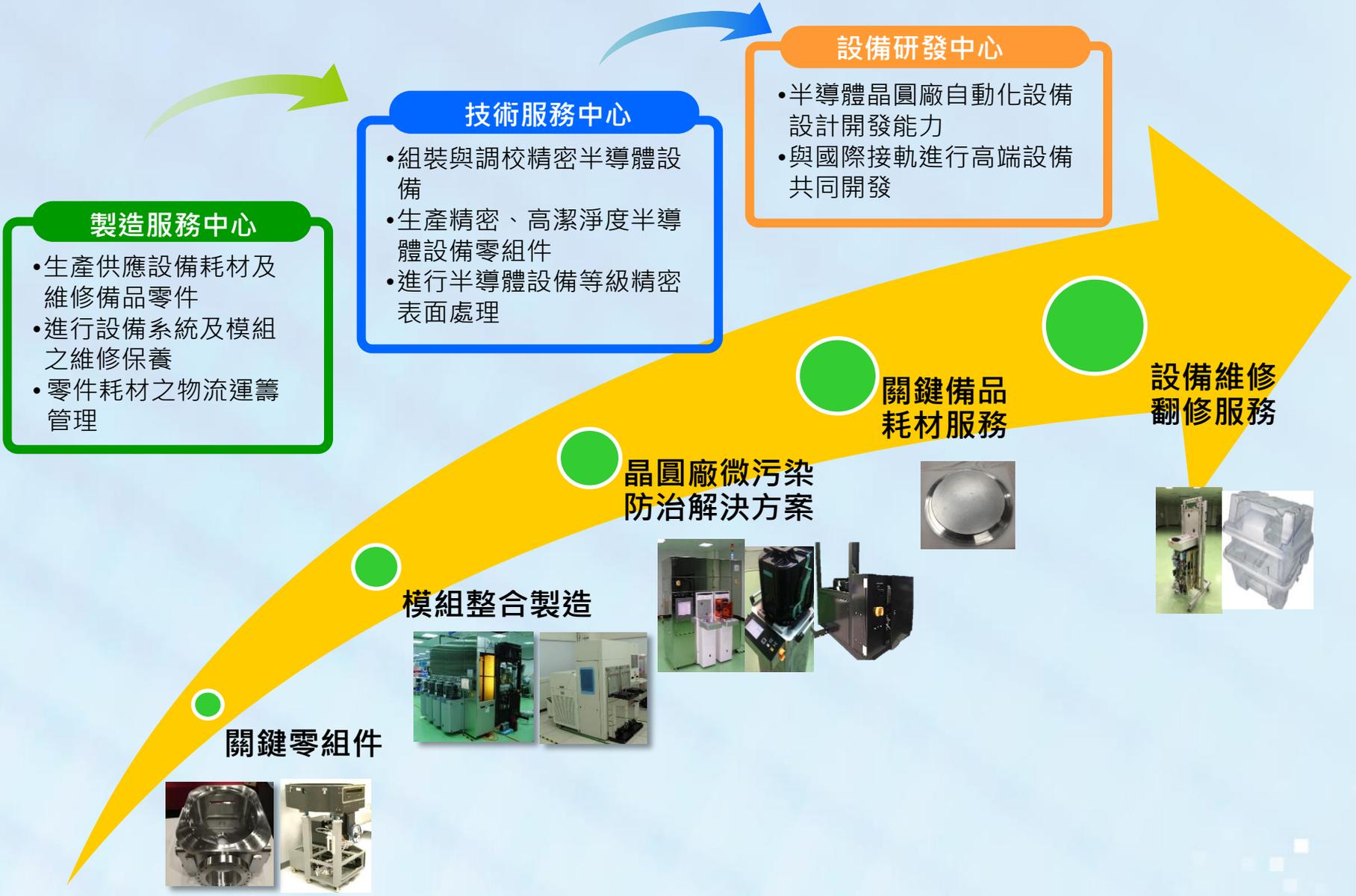
公司簡介

02

競爭優勢及發展策略

03

營運實績



**製造服務中心**

- 生產供應設備耗材及維修備品零件
- 進行設備系統及模組之維修保養
- 零件耗材之物流運籌管理

**技術服務中心**

- 組裝與調校精密半導體設備
- 生產精密、高潔淨度半導體設備零組件
- 進行半導體設備等級精密表面處理

**設備研發中心**

- 半導體晶圓廠自動化設備設計開發能力
- 與國際接軌進行高端設備共同開發

**關鍵零組件**



**模組整合製造**



**晶圓廠微污染防治解決方案**



**關鍵備品  
耗材服務**



**設備維修  
翻修服務**



半導體設備  
生命週期製造服務

- 半導體晶圓製程設備製造(蝕刻、薄膜、化學機械研磨設備)
- 太陽能/面板/LED設備製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體廠自動化  
設備自主研發

- 非製程設備開發
  - 先進製程微污染防治方案
  - 晶圓AOI檢測設備
  - 氮氣倉儲系統
  - 晶圓移載搬送自動化

設備及關鍵部件  
再生循環經濟

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務

醫療設備開發及  
製造服務

- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 智慧醫療周邊設施
- 放射治療設備

高潔淨、高真空、零污染、  
製程須符合精準複製(Copy Exact)

01

公司簡介

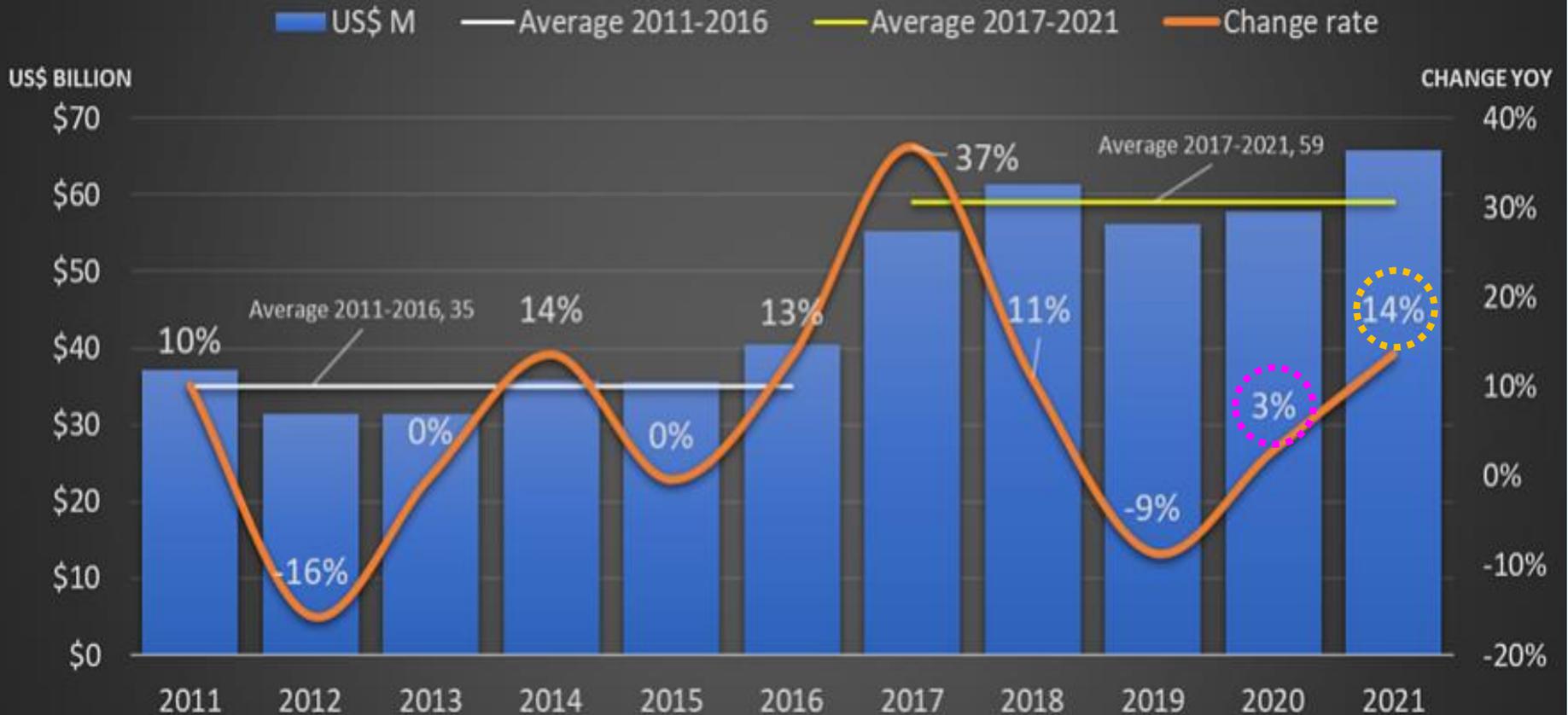
02

競爭優勢及發展策略

03

營運實績

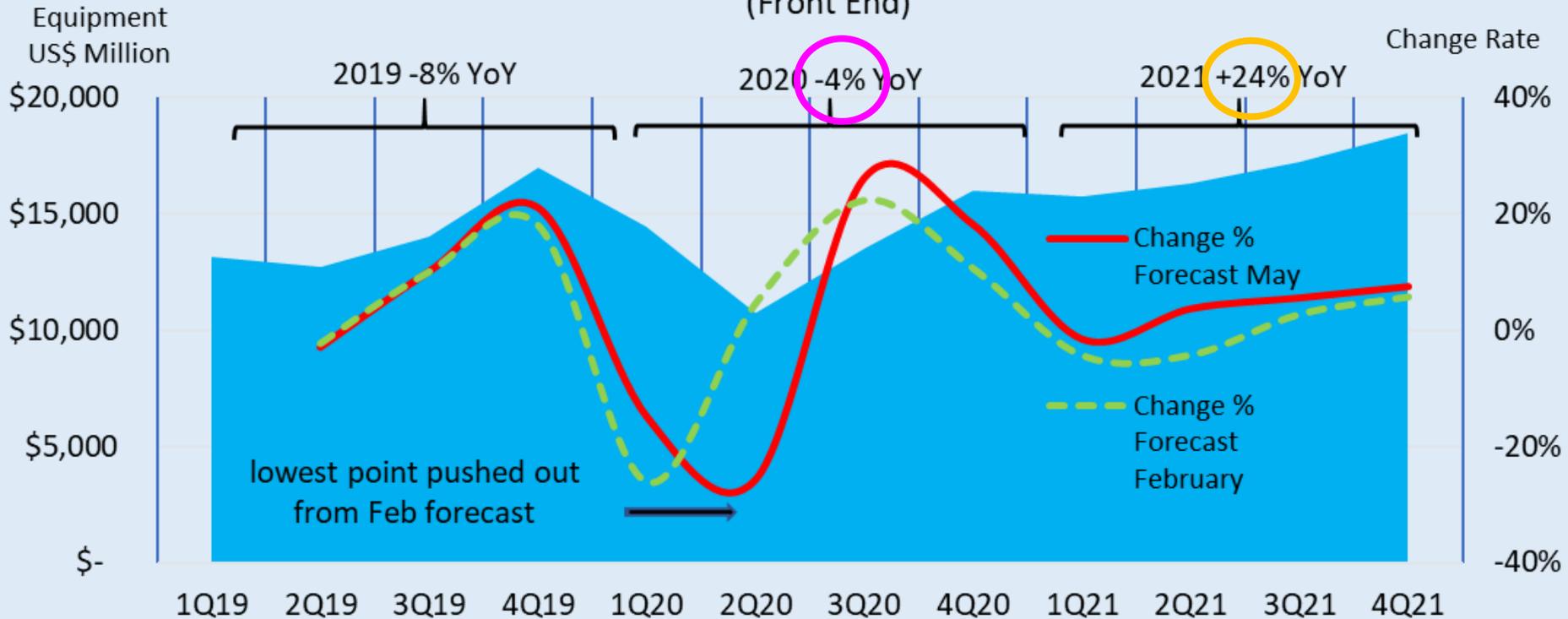
## Fab Equipment Spending



SOURCE: WORLD FAB FORECAST REPORTS, 1Q20 UPDATE, PUBLISHED BY SEMI

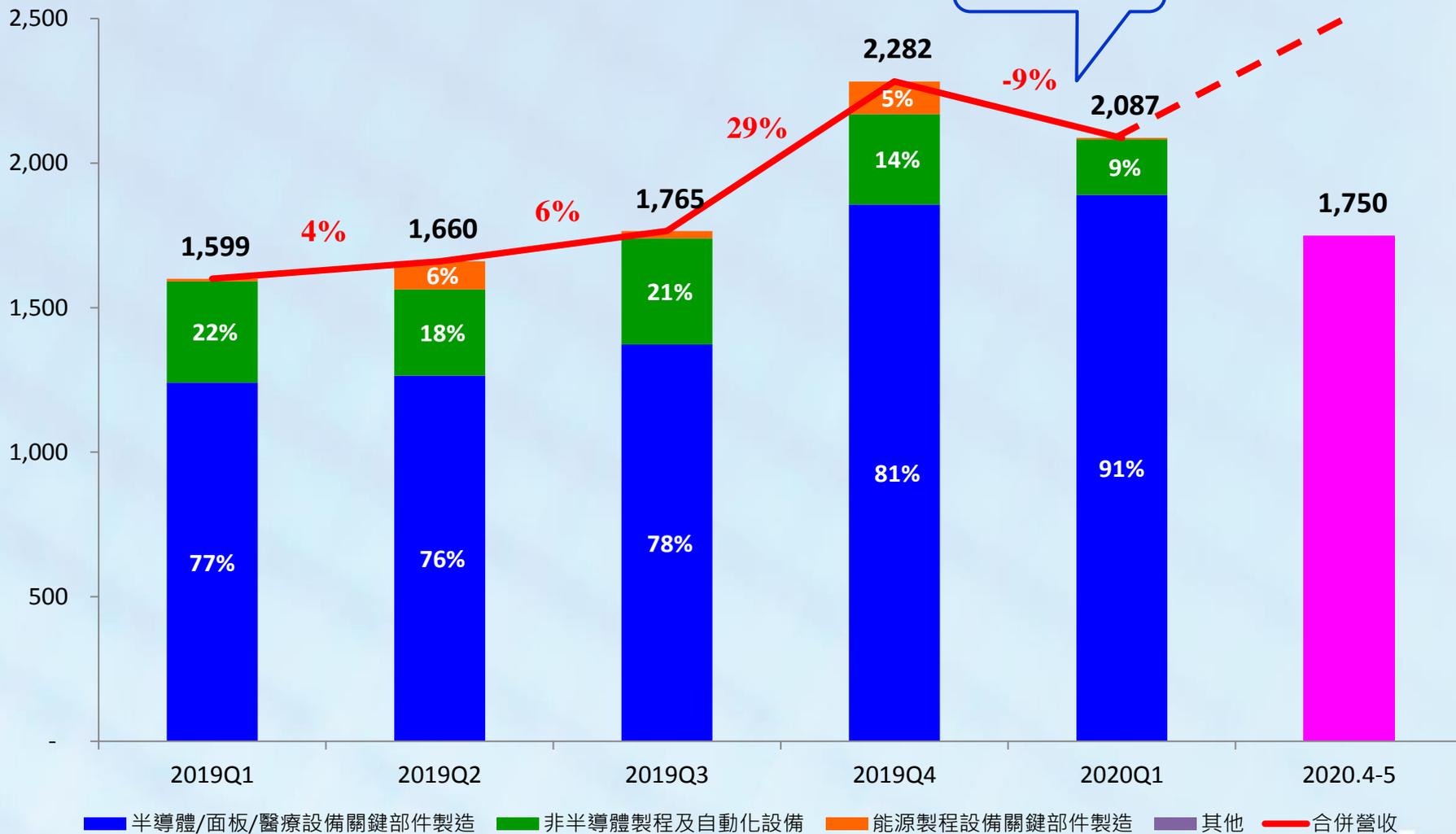
## Fab Equipment Spending

(Front End)



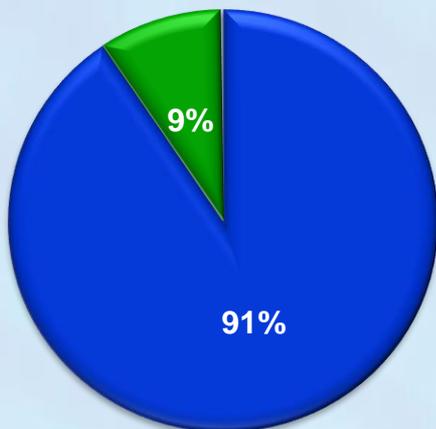
World Fab Forecast report, May 2020 update, published by SEMI

單位：百萬

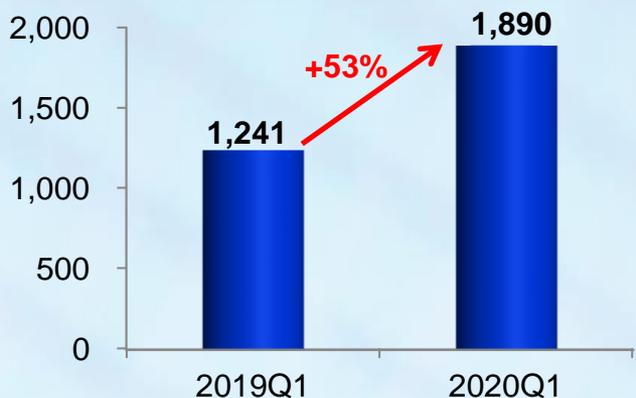


2020Q1

- 半導體/面板/醫療設備關鍵部件製造
- 非半導體製程及自動化設備
- 能源製程設備關鍵部件製造



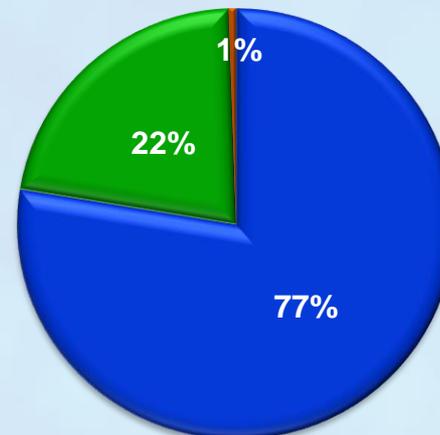
單位：百萬



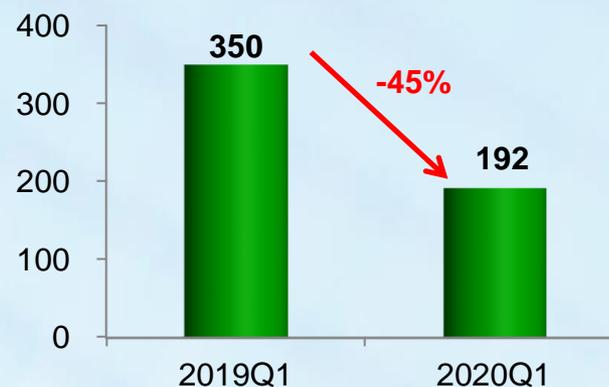
■ 半導體/面板/醫療設備關鍵部件製造

2019Q1

- 半導體/面板/醫療設備關鍵部件製造
- 非半導體製程及自動化設備
- 能源製程設備關鍵部件製造



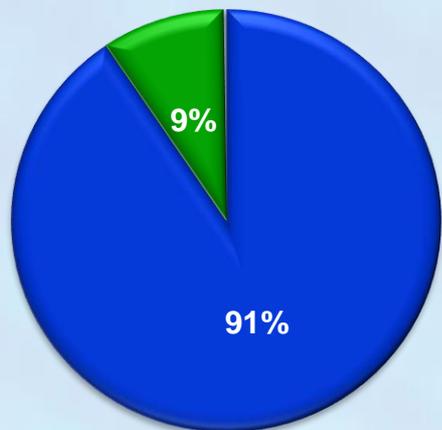
單位：百萬



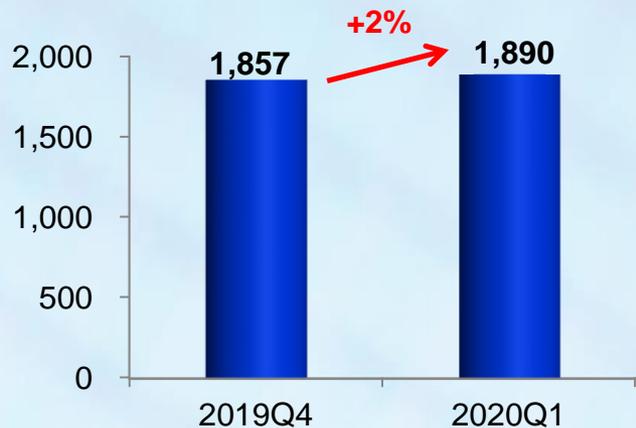
■ 非半導體製程及自動化設備

2020Q1

- 半導體/面板/醫療設備關鍵部件製造
- 非半導體製程及自動化設備
- 能源製程設備關鍵部件製造



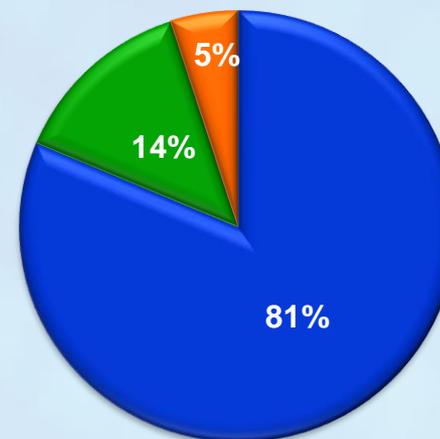
單位：百萬



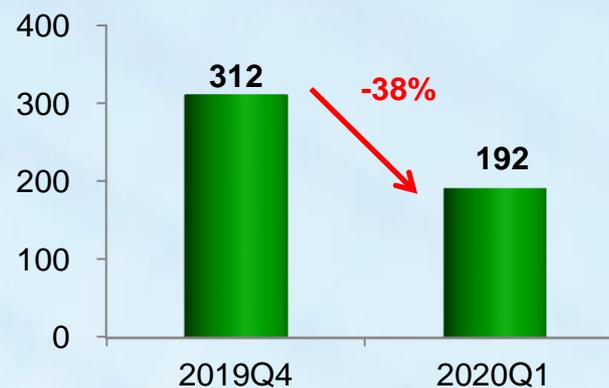
■ 半導體/面板/醫療設備關鍵部件製造

2019Q4

- 半導體/面板/醫療設備關鍵部件製造
- 非半導體製程及自動化設備
- 能源製程設備關鍵部件製造



單位：百萬

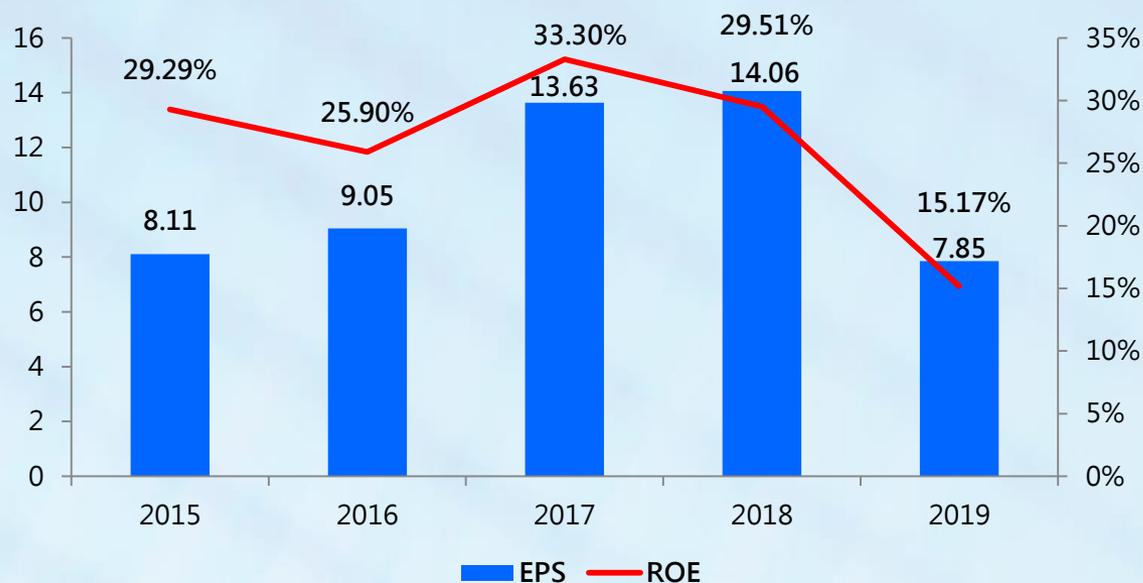


■ 非半導體製程及自動化設備

(新台幣仟元)	2020Q1	2019Q1	YoY
營業收入	2,086,841	1,599,559	30%
營業毛利率	23%	20%	3 ppts
營業費用	(213,377)	(225,840)	-6%
營業淨利	274,607	93,541	194%
營業淨利率	13%	6%	7 ppts
營業外收入及支出	12,730	8,514	50%
稅前淨利	287,337	102,055	182%
稅前淨利率	14%	6%	8ppts
歸屬於母公司業主之本期淨利	236,388	86,220	174%
純益率	12%	5%	7 ppts
每股盈餘(元)	2.86	1.04	175%
加權平均流通在外股數(仟股)	82,691	82,688	

Unit: NT\$

Year	2015	2016	2017	2018	2019
EPS (Before stock dividends)	8.11	9.05	13.63	14.06	<b>7.85</b>
Cash DPS(NT\$)	4	4	6	7	<b>4</b>
Stock DPS(NT\$)	-	0.5	0.5	-	-
Total	4	4.5	6.5	7	<b>4</b>
Payout ratio(%)	49%	50%	48%	50%	<b>51%</b>



- 京鼎公司5/28股東常會通過：
  - ◆ 配發4元現金股利
  - ◆ 董事長及原董事成員續任
  
- 業績展望：第二季樂觀、第三季稍緩，全年樂觀審慎
  
- 竹南二廠預計於第三季動土

**Thanks for your attention.**

**京鼎精密科技股份有限公司**  
**Foxsemicon Integrated Technology, Inc.**

**先進設備科技 整合領航者**